

Doc.No : NR011106

2001年11月6日

ベベル洗浄を可能にした半導体製造装置「MP-2000BEOL」を販売

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区/社長：石田 明)は配線工程に対応した200mmウエハ用枚葉洗浄装置「MP-2000BEOL」の販売を11月から開始しました。

この装置は1999年12月に発売した洗浄装置「MP-2000」を配線工程用に特化したもので、Cu(銅)配線処理を行うウエハの裏面洗浄およびベベル部(端面)の洗浄・エッチングを目的としています。半導体デバイスにおいて、集積度の向上に従い主流になりつつあるCu配線は、従来のアルミ配線に比べて電気抵抗が低く形状も微細化が可能のため、使用するウエハは裏面やベベル(端面)といった部分も含め、より徹底したパーティクル(ゴミ)除去が求められます。今回、そうした要求に対応して、MP-2000のチャンバー部を大幅に改良し、ウエハ裏面からエッチング液、純水リンスを連続吐出させることでウエハの裏面およびベベル部の洗浄を可能にしました。従来機同様、薬液処理および純水リンス、乾燥の全行程を同一のチャンバー内で処理するワンチャンバー処理方式を採用。周囲の空気による汚染を低減するとともに、薬液、リンスの消費量や搬送等の時間を大幅に削減しています。またウエハ表面への回り込み幅をレシピにより制御できます。

< 発売日 >

2001年11月上旬

< 標準価格(税別)>

1.3~1.5億円(仕様により異なる)

< 年間販売台数 >

30台/年



Cu配線に対応した枚葉洗浄装置「MP-2000BEOL」

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上ル4丁目